

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年5月8日(08.05.2025)



(10) 国際公開番号
WO 2025/094887 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) **C09J 201/00** (2006.01)
C09J 183/07 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/038343

(22) 国際出願日: 2024年10月28日(28.10.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-188147 2023年11月2日(02.11.2023) JP
特願 2023-188281 2023年11月2日(02.11.2023) JP
特願 2023-188203 2023年11月2日(02.11.2023) JP

(71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 (JP).

(72) 発明者: 奥野 貴久 (OKUNO Takahisa); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP). 柳井 昌樹(YANAI Masaki); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研

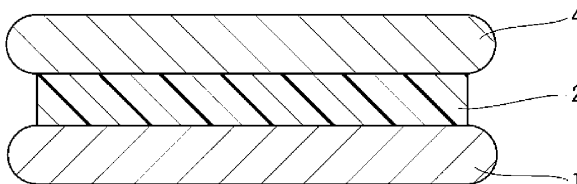
究所内 (JP). 臼井 友輝(USUI Yuki); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP). 新城 徹也(SHINJO Tetsuya); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP).

(74) 代理人: 高岡 亮一, 外 (TAKAOKA Ryoichi et al.); 〒1710021 東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル5階 高岡IP特許事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,

(54) Title: ADHESIVE COMPOSITION, LAMINATE, AND METHOD FOR MANUFACTURING PROCESSED SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 接着剤組成物、積層体、及び加工された半導体基板の製造方法



(57) Abstract: Provided is an adhesive composition for forming an adhesive layer to be used in temporarily bonding a semiconductor substrate or an electronic device layer and a support substrate, wherein: after the semiconductor substrate or the electronic device layer and the support substrate are temporarily bonded via the adhesive layer, the force required for inserting a material having a sharp portion between the semiconductor substrate or the electronic device layer and the support substrate when the semiconductor substrate or the electronic device layer is mechanically peeled from the support substrate using the aforementioned material is 10.0 kgf or lower; and the storage elastic modulus of the adhesive layer is 30 MPa or higher.

(57) 要約: 半導体基板又は電子デバイス層と、支持基板とを仮接着することに用いられる接着剤層を形成するための接着剤組成物であって、前記半導体基板又は前記電子デバイス層と前記支持基板とを前記接着剤層を介して仮接着した後に、前記半導体基板又は前記電子デバイス層と前記支持基板とを鋭部を有する機材を用いて機械的に剥離する際の、前記半導体基板又は前記電子デバイス層と前記支持基板との間へ前記機材を差し込む力が、10.0 kgf以下であり、前記接着剤層の貯蔵弾性率が、30 MPa以上である、接着剤組成物。

[続葉有]

WO 2025/094887 A1

SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))